



产品技术参数规格

ZH 8210 导电性胶粘剂

1 产品简介:

昭华科技 ZH 8210 高导热导电胶可粘接蓝宝石、硅、银、铜、陶瓷等同种或异种材料,适用于大功率 LED 等半导体发光元器件封装工艺,适合各种点胶工艺,具有低模量,高导热率,极少的溢流,附着力强等特点。

2 产品特点:

- (1) 单组分,使用工艺简单,操作方便;
- (2) 纯度高,杂质离子含量低;
- (3) 高导热,导电率高,导电性能稳定;
- (4) 粘结强度高,与多种基材都具有优良的粘接性能;
- (5) 储存稳定性好,受环境因素影响小等;
- (6) 可以满足微电子厂家要求波峰焊的高温粘结性能。

Typical Uncured Properties 参数名称		ZH 8210	Test Description 测试方法描述	Test Method 测试方法
Filler type 填充料		Ag		
Viscosity @ 25°C 粘度		18000-20000 cps	ZH-087	ATM-0018
Thixotropic index 触变指数		>5	ZH-032	ATM-0089
Work life @ 25°C 工作时间		4 hours	ZH-053	ATM-0087
Storage life @ -40°C 储存时间		>6 months		ATM-0068
Weight loss on cure 热失重		3.8 %	ZH-044	ATM-0073
Recommended cure condition 建议烘烤条件		Ramp to @ 150°C/90min		
Ionics	Chloride Cl ⁻	< 0.1 ppm	ZH-032	ATM-0007
	Sodium Na ⁺	< 5 ppm		
	Potassium K ⁺	< 0.2 ppm		
Thermal Conductivity 导热系数		20 W/mK	ZH-018	ATM-0116
Volume Resistivity 电阻率		2×10^{-5} ohm-cm	ZH-035	ATM-0082
Die shear strength (N/m ²) (Post cure) 推力测试		$\geq 7 \times 10^7$	ZH-042	ATM-0052



包装规格：


100g/瓶、200g/瓶、500g/瓶，特殊包装规格需另商议。

储存条件：

冷冻状态下-15℃至-40℃存储，室温下解冻 30-60 分钟后均匀搅拌后才可使用，针筒包装免搅拌，未用完的胶水需严格密封后再冷藏。

重要声明：

本产品样本中提供的技术参数仅供参考，以上数据信息是基于在环境温度 25℃、相对湿度 70%环境下对产品测试所得到的典型数据，以便广大客户使用时提供可能的建议。它们会随不同的工况条件，如设备类型、材质、工艺条件等改变。

我公司商标为 ，如非我公司标签产品，请勿参照此说明书，因此引起的任何后果，我司将不承担任何责任。

使用产品之前，请仔细阅读材料安全资料，产品及产品使用说明。使用者应先确定产品是否符合所需之用途，需承担使用这些产品有关之风险和责任。卖方不向使用者或其他有关人士承担因使用（包括不当使用）卖方的产品而引起的伤害或任何直接、间接、意外或后续性损失的责任。